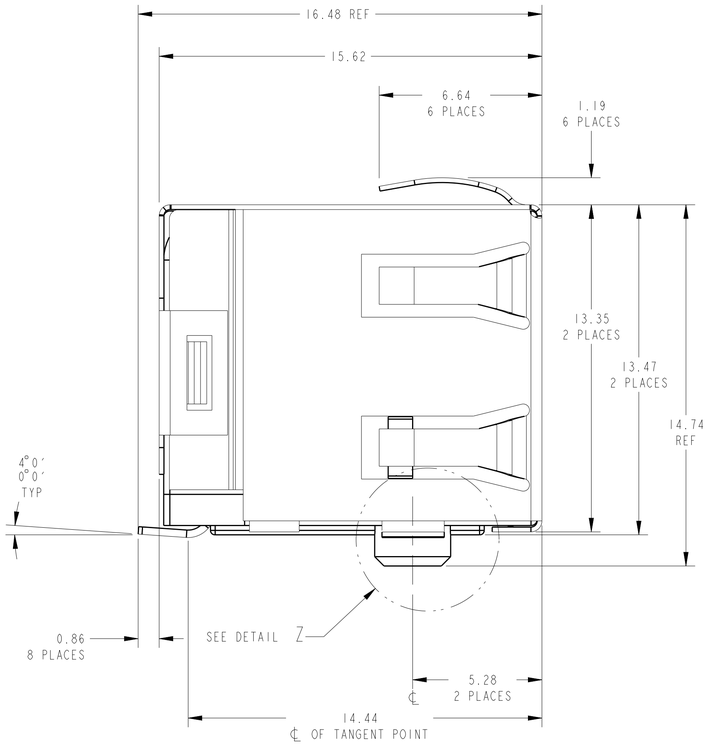
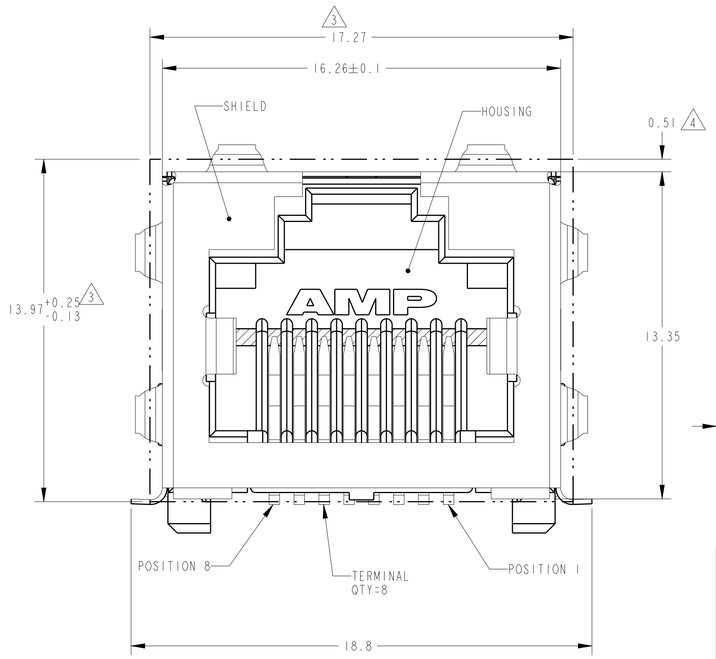
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 19
© COPYRIGHT 20 - ALL RIGHTS RESERVED.

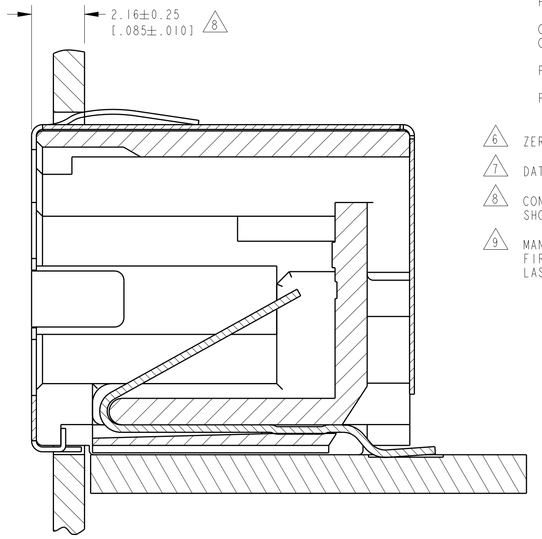
LOC	DIST
IR	-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	09AUG2012	SS	RRP







1. MATERIAL:
   HOUSING - HIGH TEMP. THERMOPLASTIC - LCP, COLOR: SEE TABLE, UL94V-0.
   TERMINALS - 0.30 THICK PHOS BRONZE PLATED WITH
   2.03µm MIN THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA.
   GOLD (SEE TABLE) IN LOCALIZED PLATE AREA OVER
   1.27µm MIN THICK NICKEL.
   SHIELD - (SEE TABLE) 0.196 THK BRASS PREPLATED WITH 2.03µm-3.81µm
   THICK MATTE TIN OVER 0.76µm-2.03µm NICKEL
   UNDERPLATE, OR 0.76-2.03µm NICKEL WITH SELECTIVE
   TIN PLATED SOLDER TABS

2. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUBPART F.

3. SUGGESTED PANEL OPENING DIMENSIONS. SEE APPLICATION SPEC. 114-2154 FOR PANEL THICKNESS AND POSITION RECOMMENDATIONS

4. SUGGESTED CLEARANCE BETWEEN TOP OF CONNECTOR AND TOP PANEL OPENING

5. PACKAGED: POCKET TAPE & REEL (PER EIA 481 SPECIFICATIONS)

   POCKET TAPE WIDTH - 44mm
   POCKET PITCH - 24mm
   POCKET DEPTH - 16.7mm

   CLEAR COVER TAPE, PSA
   CLEAR COVER TAPE TRAILER - 1220mm, WRAPPED ON REEL HUB

   PLASTIC REEL - 381mm DIAMETER

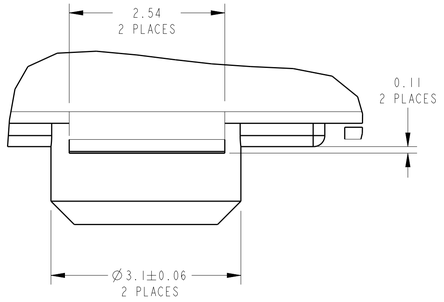
   PRODUCT QUANTITY - 200 PIECES PER REEL

6. ZERO INSERTION FORCE POST WITH RECOMMENDED PCB LAYOUT

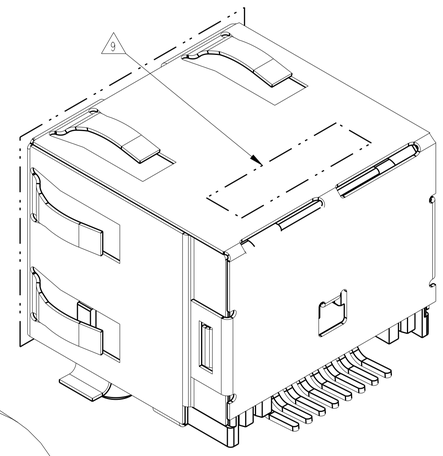
7. DATUM ESTABLISHED BY CUSTOMER.

8. CONNECTOR SHOULD BE POSITIONED THRU PANEL CUTOUT AS SHOWN TO SUPPORT TOP OF MODULAR JACK FOR STRAIN RELIEF.

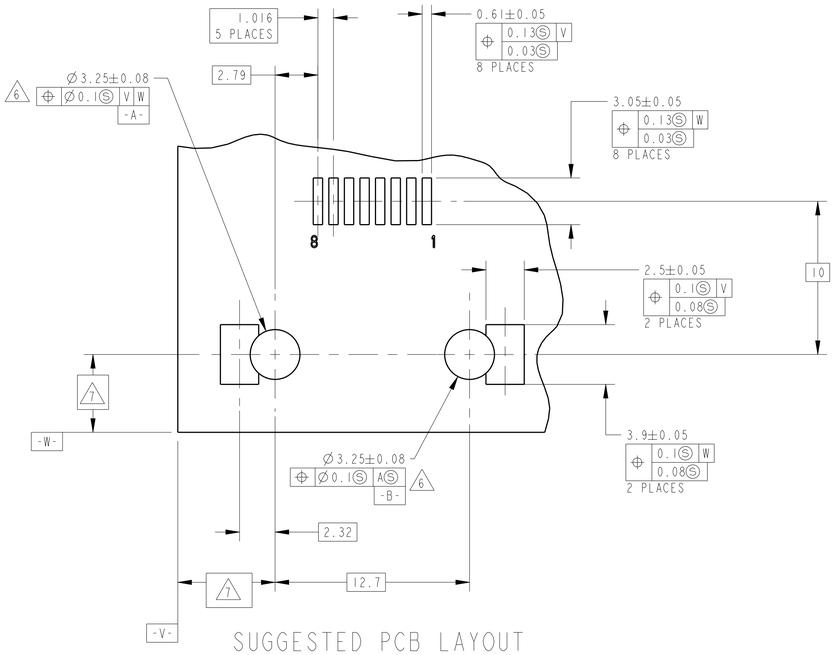
9. MANUFACTURING DATE CODE LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN. FIRST 2 DIGITS ARE YEAR, SECOND 2 DIGITS ARE WORK WEEK, LAST DIGIT IS THE DAY OF THE WEEK



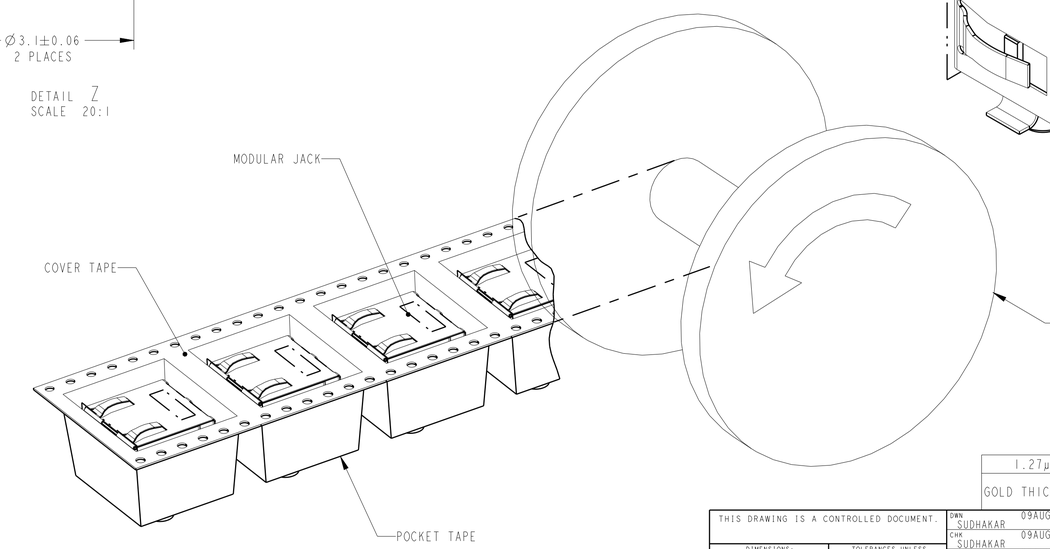
DETAIL Z
SCALE 20:1



SCALE 6:1



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



1.27µm	MATTE TIN	BLACK	2178415-1
GOLD THICKNESS	SHIELD PLATING	HOUSING COLOR	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±0.25
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±-

MATERIAL SEE NOTE 1
FINISH SEE NOTE 1

DWN SUDHAKAR 09AUG2012
CHK SUDHAKAR 09AUG2012
APVD RAJENDRA 09AUG2012
PRODUCT SPEC 108-1163-7
APPLICATION SPEC 114-6040/114-2154
WEIGHT -

TE Connectivity

NAME
INVERTED MOD JACK ASSEMBLY, 1X1, SHIELDED SURFACE MOUNT, 8 POSITION RJ45

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-2178415	-

Customer Drawing | SCALE 8:1 | SHEET 1 OF 1 | REV A

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9